

边缘保护技术

为了进一步提升 MLF® 封装设计的稳固性，Amkor 开发出一种边缘保护技术，在加工操作（如测试和表面贴装封装 (SMA)）中为器件的边缘提供保护。

从 20 世纪 90 年代末开始，Amkor 的 MicroLeadFrame® 封装就因为其尺寸优势、稳定的性能品质和集成可焊侧翼而快速被汽车行业所采用。Amkor 提供冲压和切割形式的 MLF® 封装，以满足汽车行业严格的应用需求，并被公认为汽车行业 QFN 封装的优质供应商。

作为提供优质 QFN 封装解决方案以因应汽车行业已知挑战的领导者，Amkor 公司持续开发强化结构以扩展 MLF 封装的能力。借助于成熟的凹槽引脚技术，冲压式 MLF 一直都是汽车应用的首选形式。

随着 Amkor 的边缘保护技术改善了封装设计的稳固性，这项创新的优化技术快速地被采纳，尤其在测试领域。通过强化冲压式 MLF 封装的边缘，测试引发的损坏被显著地降低。

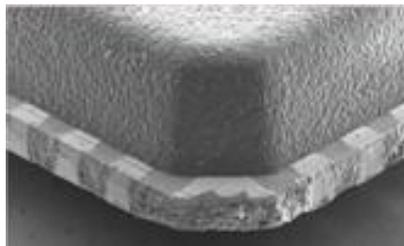
Amkor 现在为其不同尺寸的冲压式 MLF 封装提供边缘保护技术。

边缘保护 技术 考虑因素

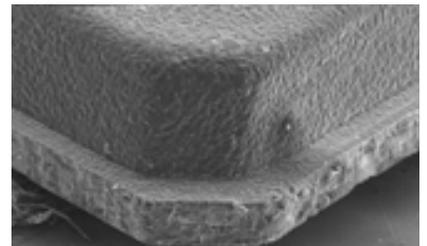
Amkor 的封装优化技术能在加工、测试和组装工艺中对 MLF® 封装的边缘进行保护。

优势

- ▶ 增加封装边缘的强度
- ▶ 避免测试引发的损坏
- ▶ 避免常见的加工损坏
- ▶ 不改变封装面积



无边缘保护



有边缘保护

访问 amkor.com 或发送电子邮件至 sales@amkor.com 以获得更多信息。



关于本文档中的信息，Amkor 对其准确性或使用此类信息不会侵犯第三方的知识产权不作任何担保或保证。Amkor 对因使用或依赖它而造成的任何性质的损失或损害概不负责，并且不以此方式默示任何专利或其他许可。本文档不以任何方式扩展或修改 Amkor 其任何产品的标准销售条款和条件中规定的保修。Amkor 保留随时对其产品和规格进行更改的权利，恕不另行通知。Amkor 名称和标志是 Amkor Technology, Inc. 的注册商标。所提到的所有其他商标是各自公司的财产。

© 2018 Amkor Technology Incorporated. 保留所有权利。TS112A 修改日期：9/18